

ห่วงโซ่ชิปเอเชีย พลังขับเคลื่อน AI

ASEMI24 | 3119 HK | Asia | Semiconductor

ASEMI24 อ้างอิงหลักทรัพย์ Global X Asia Semiconductor ETF (3119 HK) ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Semiconductor ชั้นนำของเอเชีย 3540 บริษัท กระจายตัวอยู่ในตลาดไต้หวัน (30%) เกาหลี (25%) ญี่ปุ่น (23%) และจีน/ฮ่องกง (22%) และมีการปรับสัดส่วนช่วงเดือน มี.ค. และ ก.ย.

Key Data

DR Price	4.58 THB
UL Price	200 HKD
Conversion Ratio	1UL : 200 DR
Valuation	16x P/E
Est. EPS (12Y)	20–45% CAGR
Volatility 30 Days	56%

Note: UL = Underlying, DR = Depository receipt, CAGR = Compound Annual Growth Rate, P/E = Next-Twelve-Months Price to Earnings Ratio; Sources: Bloomberg, FSS

Riding on the Chip Wave

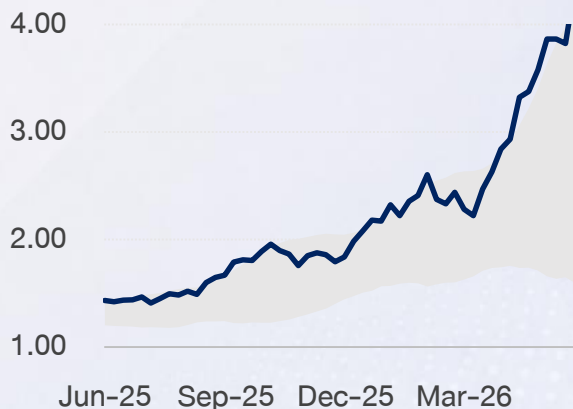
ราคาหุ้น Asia Semiconductors ในปี 2025 แกว่งตัวในกรอบกว้าง ก่อนเข้าสู่จังหวะปรับฐานในเดือนมีนาคม 2026 จากความกังวลเรื่องสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน อย่างไรก็ตาม ราคาสสามารถกลับมาฟื้นตัว หลังผลการประกอบการไตรมาสไตรมาสแรก ในปี 2026 ออกมาแข็งแกร่ง และแนวโน้มความต้องการชิปจาก AI และ Data Center ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Asia's Chip Ecosystem

ASEMI24 ลงทุนในกลุ่ม Semiconductor เอเชียทั้งห่วงโซ่การผลิตชิป นำโดย SK Hynix (8.8%) ผู้ผลิตหน่วยความจำจากเกาหลี, MediaTek (9.8%) ผู้นำชิปประมวลผลสำหรับสมาร์ตโฟน จากไต้หวัน, Tokyo Electron (5.6%) ผู้นำอุปกรณ์ผลิตชิปชั้นนำของญี่ปุ่น และ Cambricon (2.9%) ผู้พัฒนา AI Chip ชั้นนำของจีน

เราคาดว่ากำไรของบริษัทในกลุ่มนี้จะเติบโตในระดับสูงราว 20–45% ต่อปีในช่วง 1–2 ปีข้างหน้า จากการลงทุนใน AI Data Center ที่หนุนความต้องการชิป และเทคโนโลยีบรรจุชิปขั้นสูง ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อ คือ ความต่อเนื่องของการลงทุนด้าน AI จากกลุ่ม Hyperscalers

Currency Adj. Underlying Price (THB)



Note: The shaded area represents ± 2 Standard Deviations from the mean based on 20week rolling data. Price reflects the underlying price converted using the DR conversion ratio; Source: Bloomberg, FSS



ดร.จิติพา พุกขามรานันท์

นักวิเคราะห์ตลาดทุน: 027168

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์: สุนพรรณ แก้วโบราณ

ASEMI24: Depositary Receipt on ASEMI ETF Issued by FSS

DR	UL	%1M	%CCY	V30D	P/E	Description
ASEMI24	3119 HK	21.3	2.7	56	16	Global X Asia Semiconductor ETF ลงทุนในอุตสาหกรรม Chip เอเชียครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

Top 5 Constituents by 1-Month Performance

No.	UL	%1M	%CCY	V30D	P/E	Description
1	1303 TT	80.8	1.6	83	21	Nan Ya Plastic Corp – ผู้ผลิตพลาสติกเคมีภัณฑ์ โพลีเอสเตอร์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
2	2344 TT	68.5	1.6	102	7.8	Windbond Electronics Corp – ผู้ผลิต DRAM เฉพาะทางรายใหญ่ของไต้หวัน
3	2408 TT	57.4	1.6	106	8.4	Nanya Tech – ผู้ผลิตชิป DRAM สำหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์
4	285A JP	52.7	1.1	112	10	Kioxia Hold. (KIOXIA) บริษัทญี่ปุ่นผลิตหน่วยความจำแฟลช และ SSD
5	1347 HK	47.8	2.7	100	143	Hua Hong Semiconductor (HUAHONG) ผู้ผลิต Chip ยานยนต์ และอุปกรณ์ IoT

Bottom 5 Constituents by 1-Month Performance

No.	UL	%1M	%CCY	V30D	P/E	Description
36	6503 JP	-9.4	1.1	52	25	Mitsubishi Electric – กลุ่มอุตสาหกรรม และ อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐาน
37	3653 TT	-10.2	1.6	76	48	Jentech Precision – ผู้ผลิตชิ้นส่วนระบายความร้อน และชิ้นส่วนโลหะความแม่นยำสูง
38	6758 JP	-10.3	1.1	30	16	Sony Group (SONY) ผู้ผลิตอุปกรณ์ Electronics และสื่อบันเทิงจากญี่ปุ่น
39	7769 TT	-12.2	1.6	67	48	Hon Precision – ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะความแม่นยำสูงสำหรับอุปกรณ์ผลิตชิป
40	042700 KS	-14.1	0.5	130	65	Hanmi Semiconductor – ผู้ผลิตอุปกรณ์บรรจุชิปสำหรับ HBM และการบรรจุชิปขั้นสูง

Note: DR = Depositary receipt, UL = Underlying, %1M = Price Change 1 Month, %CCY = Price Change in Underlying Equity Currency, V30D = Price Volatility in 30 Days, P/E = Next-Twelve-Months Price to Earnings Ratio; Sources: Bloomberg, FSS

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ: Depositary Receipts หรือ DR และเงื่อนไขผลตอบแทนก่อนตัดสินใจลงทุน เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของตราสาร ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สภาพคล่อง สภาพตลาดต่างประเทศ และการกระจายการถือตราสารไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นต้น ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต บล. ฟินันเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้ออก และผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ของ DR ลงท้ายด้วยรหัส 24 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลและความคิดเห็นในรายงานฉบับนี้ อ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯฯ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วน และอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า